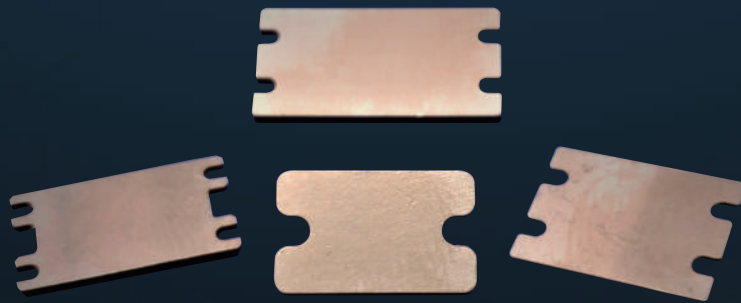


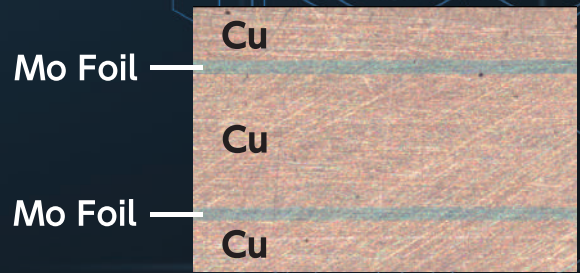
# S-CMC®

(スーパーCMC 半導体用ヒートシンク)

銅とモリブデンのクラッド材による高熱伝導、  
低熱膨張の半導体用ヒートシンクを開発しました。



各種ヒートシンク材 (加工例)

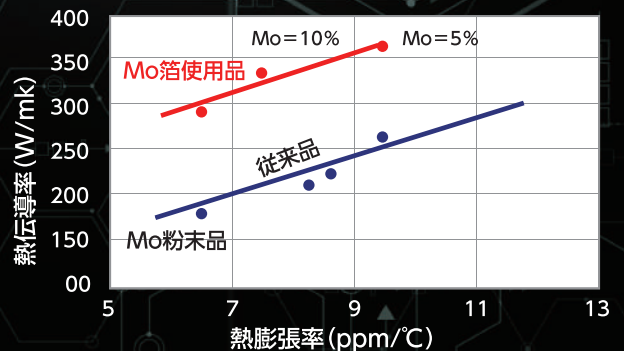


S-CMC®の断面構造

## FJC製 S-CMC®の特徴

- 弊社が独自に開発したCu箔とMo箔を多層に積層したクラッド材
- 日・米・中・欧にて特許取得済み、日・米・中にて商標登録を実施  
(特許: 日3862737、US7951467、CN101291769B、EU1944116) (商標登録: 5764464)
- Moの使用量は、目的により自由に選択可能で、ご希望の熱膨張率に対応可能
- GaN素子を使用した衛星通信デバイスに10年以上の使用実績を有する
- 5G通信用の携帯電話基地局のデバイスの放熱原料として期待される

Mo含有割合 (%)		Mo=5%	Mo=10%	Mo=20%	Mo=40%
熱伝導率 (W/mk)	板厚方向	362	335	291	230
	面方向	381	369	344	290
熱膨張係数 (ppm/°C)	室温-250°C	14.8	11.8	7.4	6.6
	室温-400°C	13.5	9.3	6.8	6.2
	室温-800°C	9.5	7.5	6.5	6.2



FJ Composite

〒066-0009 北海道千歳市柏台南2丁目2-3 TEL 0123-29-7034 FAX 0123-29-7035

<https://www.fj-composite.com>

